

H500-R 高导热系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30°C

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H500-R 导热硅胶垫片，是一款超高导热的热界面材料。产品具有较好的电气绝缘特性及耐温性能，产品防火性能高，能够较好地填充间隙，实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于新能源产品中。

产品性能

| NO. | 参数 | 单位 | 测试方法 |
|------|-----------------|---------|----------------|
| 颜色 | 灰色 | --- | 目视 |
| 厚度 | 0.5~3 | mm | ASTM D 374 |
| 硬度 | 35~50(±5) | Shore C | ASTM D 2240 |
| 密度 | 3.1±0.5 | g/cc | ASTM D 792 |
| 拉伸强度 | ≥0.15 | Mpa | ASTM D 412 |
| 延伸率 | ≥60 | % | ASTM D 412 |
| 压缩比 | ≥15 (@50psi) | % | ASTM D 695 |
| 阻燃等级 | V-0 | --- | UL-94 |
| 使用温度 | -50~150 | °C | IEC 60068-2-14 |

热学特性

| | | | |
|------|----------------------|----------------------|-------------|
| 导热系数 | 5.0±0.5 | W/m·K | ASTM D 5470 |
| 热阻 | ≤0.6 (@20Psi/1mm) | °Cin ² /W | ASTM D 5470 |

电学特性

| | | | |
|-------|------------------|-------|------------|
| 击穿电压 | ≥3 | KV/mm | ASTM D 149 |
| 体积电阻率 | ≥10 ⁸ | Ω·cm | ASTM D 257 |
| 介电常数 | ≥5 | @1MHz | ASTM D 150 |
| 介质损耗 | ≤0.1 | @1MHz | ASTM D 150 |

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权